



2021年10月20日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
 ( J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0 )  
 問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広  
 ( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

**当社持分法適用関連会社(半導体ウエーハ事業)による海通証券(主幹事証券) との上場に関する  
 アドバイザリー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録受理のお知らせ**

2021年6月29日付開示「半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ」、2021年6月30日開示「(開示事項の訂正) 半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ」にてお伝えしました通り、当社の持分法適用関連会社である杭州中欣晶園半導体股份有限公司(以下、「CCMC」)は、今期決算(2021年12月期)をもって、中国のハイテク市場である上海証券取引所科创板市場への上場を目指して準備中ではありますが、このたびCCMCは、中国の大手証券会社である海通証券股份有限公司(住所: 中華人民共和国上海市黄浦区広東路689号、董事長 周杰 以下、「海通証券」)と上場に関するアドバイザリー契約を締結し、当該契約に基づき、海通証券が上場に関する審査開始について中国証券監督管理委員会(以下、「証監会」)へ登録を行い、証監会に受理されましたので、以下の通りお知らせ致します。なお、本登録の受理により、科创板市場への上場に向け更に一步前進出来たものと考えております。引き続き、CCMCの上場に向けて、当社グループ一丸となって、準備を進めて参ります。

記

## 1. 本件概要

(1) 主 幹 事 証 券	海通証券股份有限公司
(2) アドバイザリー契約締結日	2021年9月28日
(3) 証 監 会 登 録 受 理 日	2021年10月20日
(4) 上 場 申 請 予 定 時 期	2022年4月から6月の間に上場申請を予定

## 2. CCMCの概要

(1) 名 称	杭州中欣晶園半導体股份有限公司	
(2) 所 在 地	中華人民共和国浙江省杭州市钱塘新区東垦路888号	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢	
(4) 事 業 内 容	半導体ウエーハの製造・販売	
(5) 資 本 金	50.3億人民元(約880.25億円)	※1人民元=17.5円
(6) 設 立 年 月 日	2017年9月28日	
(7) 大株主及び持ち分比率	杭州大和熱磁電子有限公司(連結子会社)	14.4071%
	上海申和熱磁電子有限公司(連結子会社)	8.6442%
	嘉善嘉和股权投资合伙企业	9.4899%

(8) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	当該会社は当社の持分法関連会社です。
	人的関係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任。
	取引関係	該当事項はありません。

2021年9月30日現在

### 3. 今後の見通し

本件による当社の今期の業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以上

この文書は、当社持分法適用関連会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司の科创板市場への株式上場へ向けた準備に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではなく、またこの文書又はその一部は、中国、日本、米国その他の地域において関連する契約、約束又は投資判断の基礎を成すべき又は依拠されるものではありません。したがって、この文書は、米国を含むいかなる法域においても、株式又は有価証券の募集又は取得勧誘を構成し又は意図するものではありません。米国においては、登録又は登録免除なしに有価証券の募集販売はできません。公募を通じた有価証券の購入は、当該有価証券に関する最終のオフERING・メモランダム又はプロスペクタスに含まれる情報のみを基礎として行われるべきです。現時点において、当社は米国において有価証券の公募を行う意図を有していません。